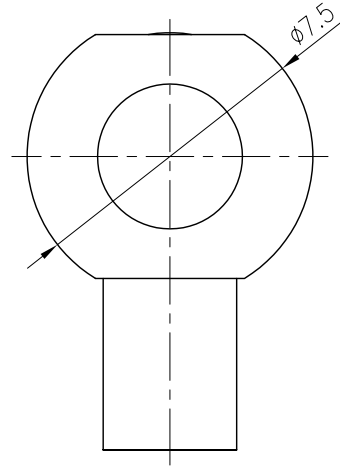
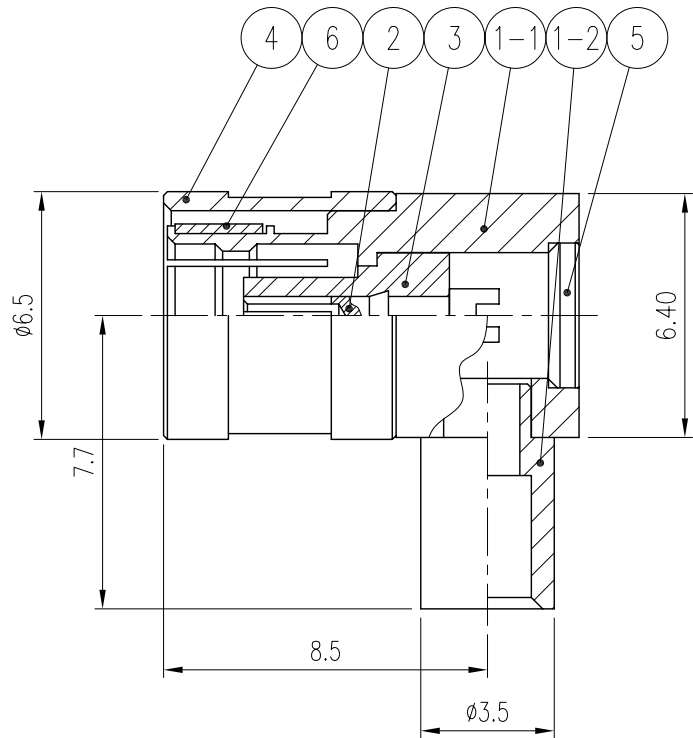


기 종											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											△				
ST(개선)											△				



6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)	
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00013-15/1 (L1001)	
4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00024-135/1 (K3005)	
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00327-N/1 (H3075)	
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00365-1345/1 (E3079)	
1	1-2 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00085-5/1	DBD01322-1/1
	1-1 BODY	1	MBsBD	Gold Plate		DBD00461-3/1

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2000. 4. 13.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인								
재질	검도					도명 SMB-LPS-085			
	재도								
열처리	작성부서		연 구 소			A4 도번 CN00202-7/1 K315-143-000			
보호파막처리	척도 5/1	단위 mm	중량						